

Doc.No : NR010604

2001年6月4日

## 神鋼とBGA・CSP基板検査装置事業譲渡に合意

大日本スクリーン製造株式会社(本社：京都市上京区/社長：石田 明)は、このたび、(株)神戸製鋼所機械カンパニー(本社：東京都品川区/執行社長：小谷 重遠氏)が開発・製造・販売およびアフターサービスを行うBGA・CSP基板検査装置事業の譲渡に基本合意に達しました。

これに基づき、大日本スクリーンは、譲渡対象の検査装置に関する特許、ノウハウ、商品商標、各種技術資料などの知的資産を神鋼から譲り受け、2001年9月1日から同装置の製造、販売、サービスを開始します。初年度の売上目標額は4億円、2年目は8億円を目指します。

譲渡の対象になる検査装置は、電子部品を実装する直前のプリント基板を光学的に外観検査する装置で、BGA( Ball Grid Array )やCSP( Chip Size Package )といったアレイ状の端子をもつ多ピンLSIパッケージ用のパターン上のキズや金メッキの欠けを全自動で外観検査できます。また、製造ラインで発生する異物混入、変色、金メッキ未着などの欠陥も検出できるので、高精度検査が求められる最先端のBGA・CSP基板の最終製造工程において、不良基板の流出防止と検査コストの低減を図ることができます。

このたびの事業譲渡は、当社にとって新たな最終検査機器市場への参入となり、また現在当社が取り扱っているプリント基板製造の前工程向け各種装置と共にプリント基板製造装置ビジネスの強化が図れることと、神鋼が機械カンパニーでのコア事業への集中という方針に従ったものであり、両者のメリットが一致したことによるものです。

なお、BGA・CSP基板検査装置は6月6日から東京・有明ビッグサイトで開催されるJPCA2001展にパネル展示します。



BGA・CSP基板検査装置

この画像の印刷用データ(解像度300dpi)は、下記URLよりダウンロードできます。  
(<http://www.screen.co.jp/press/photo.html>)

●本件についてのお問い合わせ先

大日本スクリーン製造株式会社 本社広報室：Tel 075-414-7131 Fax 075-431-6500 〒602-8585 京都市上京区堀川通寺之内上ル4丁目